

BUSINESS REPORT 2025

第46期 年次報告書
2024.08.01 ▶ 2025.07.31

株主メモ	
事業年度	毎年8月1日から翌年7月31日まで
定期株主総会	10月
基準日	7月31日
上記のほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めます。	
配当金支払株主確定日	期末配当金 7月31日 中間配当金 1月31日
単元株式数	100株
上場市場	東京証券取引所プライム市場
公 告 方 法	電子公告とし、当社ホームページ (https://www.samco.co.jp/) に掲載いたします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。
株主名簿管理人 (特別口座の口座管理機関)	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社
同連絡先	〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 電話 0120-094-777 (通話料無料) ※株式関係のお手続き用紙のご請求は、三菱UFJ信託銀行のホームページ (https://www.tr.mufg.jp/daikou/) でも承っております。

(ご注意)

- 株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取扱いできませんのでご注意ください。
- 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問い合わせください。なお、三菱UFJ信託銀行本支店でもお取次ぎいたします。
- 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

株主の皆さまの
声をお聞かせください

コエキク

当社では、株主の皆さまの声をお聞かせいただきたいため、アンケートを実施いたします。
お手数ではございますが、アンケートへのご協力をお願いいたします。

下記URLにアクセスいただき、アクセスキー入力後に表示されるアンケートサイトにてご回答ください。
<https://koekiku.jp>

アクセスキー

ご回答いただいた方の中から抽選で豪華景品を差し上げます。

本アンケートは、株式会社プロネクサスの提供する「コエキク」サービスにより実施いたします。
アンケートのお問い合わせ「コエキク事務局」koekiku@pronexus.co.jp

ホームページのご紹介

<https://www.samco.co.jp/>

QRコード

トップページ

samco[®]
サムコ 株式会社

証券コード 6387



samco[®]

第46期の売上高・営業利益・当期純利益は過去最高となりました。

「薄膜技術で世界の産業科学に貢献する」という経営理念のもと、事業規模の拡大を図ってまいります。

株主の皆様には平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

当社第46期（2024年8月1日～2025年7月31日）の報告書をお届けいたしますので、ご高覧賜りますようお願い申しあげます。



左：代表取締役会長兼CEO
辻 理
右：代表取締役社長兼COO
川邊 史

第46期の事業環境、経営成績

当事業年度における世界経済は、各国の通商政策等の影響や中国の景気減速懸念等を受けて不透明感が増す状況が続きましたが、欧米での経済活動は底堅く推移し、全体では緩やかな経済成長を示しました。

半導体等電子部品業界におきましては、自動車向け市場では、電気自動車（EV）の成長鈍化に伴う需要低迷が見受けられましたが、AI関連投資が盛んとなり、データセンター向け半導体需要等の高まりにより全般的に成長が継続しました。

その結果、当事業年度の国内売上高は5,755百万円（前期比30.6%増）となりました。国内ではデバイス・電子部品メーカー、大学、研究機関などで堅調な状況が続いております。一方、当事業年度の海外売上高は中国で一服感が見られたため3,586百万円（前期比5.5%減）となりました。海外売上高比率は38.4%であり、中長期的に目標としている海外売上高比率50%に向け、更なる海外事業の拡大を推進してまいります。

続いて、当事業年度の受注高は9,104百万円（前期比11.8%増）、当事業年度末の受注残高は納期短縮の効果等もあり、5,124百万円（前期比4.4%減）となりました。部材調達の長期化は改善傾向が見られるものの、装置受注から出荷までのリードタイムを短縮すべく、DXを活用した受注予測に基づく見込み生産を始めとする生産体制の整備、見直しを進めております。

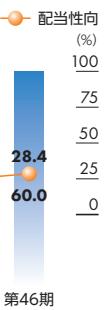
以上の結果、当事業年度における業績は、売上高9,342百万円（前期比13.9%増）、営業利益2,342百万円（前期比

16.1%増）、経常利益2,373百万円（前期比13.6%増）、当期純利益1,697百万円（前期比15.3%増）となりました。

なお、期末配当につきましては、経営体質の強化と研究開発のための設備投資等のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続する基本方針のもと、前期より1株当たり15円引き上げ、1株当たり60円00銭とさせていただきました。

株主、取引先、従業員等のステークホルダーにとって魅力ある企業を目指し、成長力と収益力の向上を図り、適切な利益配分により企業価値の向上を目指してまいります。株主の皆様におかれましては、引き続き変わらぬご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。

■ 配当金・配当性向



中期経営計画

今後の経済環境につきましては、世界経済は米国の関税政策の影響や継続する地政学的なり스크への懸念などにより緩やかな成長にとどまる見込まれます。一方、当社の製造装置利用目的の多くを占める半導体分野においては、AI関連投資への需要を中心に引き続き堅調に推移するものと見られております。

このような中にあって、当社は、「薄膜技術で世界の産業科学に貢献する」という経営理念のもと、研究開発型企業として成長してきた高度な技術力に更に磨きをかけると同時に、蓄積した技術を生産機市場で活かすことで、事業規模の拡大を図っております。加えて、当社のコアテクノロジーである「薄膜技術」は医療、バイオ、環境といったライフサイエンス及びエネルギー分野に活かすことが可能であり、中期的には当社の新規事業、新分野として成長させることを目指し事業を展開してまいります。

このような環境の下、新たな中期経営計画 第47期～第49期（2025年8月1日～2028年7月31日）を策定し、以下の重点課題に取り組み事業計画の達成に努めてまいります。

- ① 新しいプロセス及び新規装置の開発、販売
- ② 生産機（電子部品メーカーなどの生産現場での稼働を目的とする装置）販売強化
- ③ 海外販売の拡大
- ④ 生産体制の拡充
- ⑤ 更なる成長に向けた人員育成・活躍の実現
- ⑥ サステナビリティへの取り組み

以上の課題を克服し、第47期は売上高10,200百万円、第48期は11,200百万円、第49期は12,300百万円という中期経営計画の目標達成を目指します。



サムコ株式会社とは？

サムコは京都市伏見区に本社を置く半導体等電子部品の製造装置を手掛けるメーカーです。半導体や電子部品は皆様の快適な暮らしには欠かせないものとなり、当社では薄膜を形成するCVD装置・ALD装置、薄膜を微細加工するエッチング装置、基板表面をクリーニングする洗浄装置などの独自の製品を世界中に提供しています。

社名のSAMCO(サムコ)は、Semiconductor And Materials COmpanyの略で、半導体と材料開発の分野で躍進していくことを目指して名付けられています。



グローバルに事業を展開

1979年の創業以降、世界各国でグローバルに事業を展開し、現在はアジア、北米を中心に支店や子会社、販売代理店など、海外に11拠点を有しております。また、ユーザーニーズに対応した製品をタイムリーに提供すべく、「直接販売」を行っており、京都から独自の製造装置を世界中に送り続け、これまで世界36カ国に4,900台の装置を販売してきました。



サムコが注力する化合物半導体とは？

当社は半導体の中でも“化合物半導体”と呼ばれる材料に特化した装置メーカーです。化合物半導体は、一般的な半導体デバイスで使用されているシリコン（珪素）とは異なり、複数の元素を組み合わせて作られる半導体で、高速で動作する、高い耐熱性、低消費電力、発光するなどの優れた特性を持っています。



サムコの装置はどのような製品・技術に活かされている？

化合物半導体の加工や様々な電子部品の製造に、当社の装置が使われており、今後も市場の拡大が見込まれています。当社の装置を使って製造されるデバイスや最終製品の事例をご紹介いたします。

化合物半導体分野	製造されるデバイス	最終製品の事例
	LD (半導体レーザー)	データセンター
	パワーデバイス	5G・次世代通信、光通信
電子部品分野	各種電子部品 (高周波フィルタ、センサ類)	スマートフォン・ウェアラブル端末

省エネ・脱炭素社会を支えるサムコの技術

化合物半導体が用いられるLEDや次世代パワーデバイスなどは、当社の“薄膜技術”が活かされた装置によって製造されており、当社は省エネ・脱炭素社会を支えているメーカーであると言えます。持続可能な社会の実現に向けて、サステナブルな企業価値創造を目指し事業を展開しております。

詳しくは当社ホームページ
<https://www.samco.co.jp/ir/info/csr/>



TCFD | TASK FORCE ON CLIMATE-RELATED FINANCIAL DISCLOSURES

広報誌サムコナウの紹介

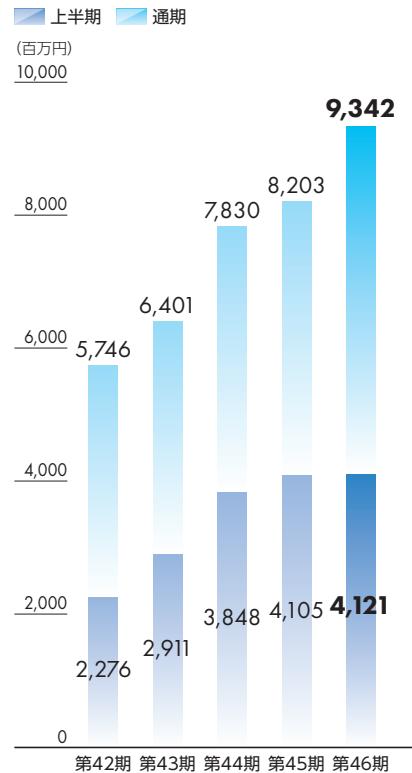
当社では、「研究者の皆様と産業界の橋渡し」をコンセプトにした広報誌サムコナウ(samco NOW)を四半期ごとに発刊しています。ユーザーの皆様のインタビューや、京都のお食事処など盛り沢山の内容となっており、バックナンバーも公開しておりますので、ぜひアクセスをお願いします。

<https://www.samco.co.jp/company/samconow/>

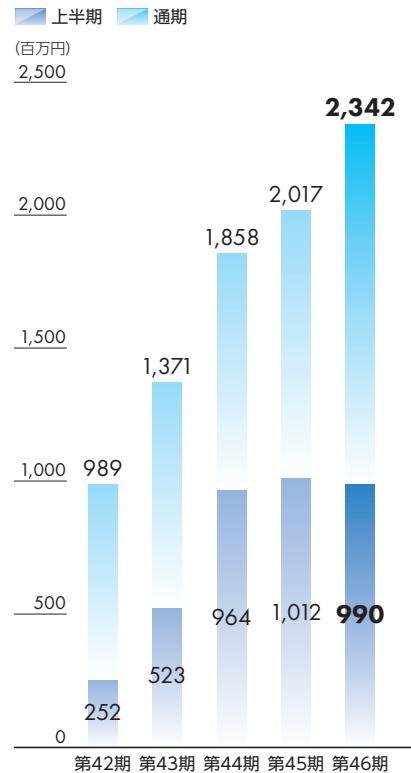


決算ハイライト

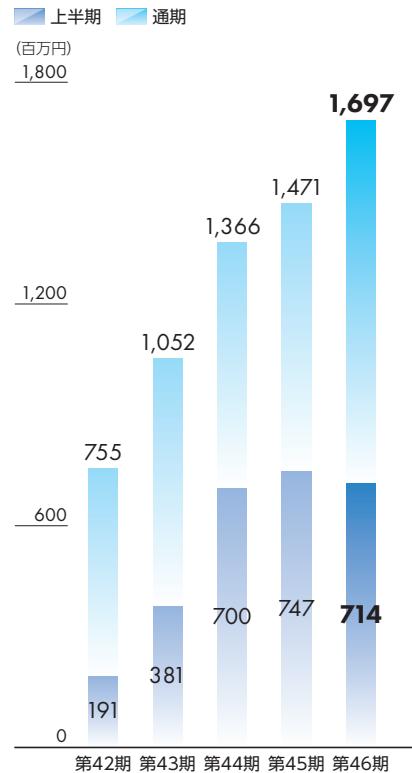
売上高
9,342百万円
前期比 **13.9%増**↑
計画比 **1.7%減**↓



営業利益
2,342百万円
前期比 **16.1%増**↑
計画比 **5.5%増**↑



当期純利益
1,697百万円
前期比 **15.3%増**↑
計画比 **10.9%増**↑



財務諸表

貸借対照表 単位：千円（未満切り捨て）

科 目	当 期 (2025年7月31日現在)	前 期 (2024年7月31日現在)
(資産の部)		
流動資産	12,521,999	11,188,327
固定資産	5,252,225	4,927,698
有形固定資産	4,455,043	4,096,707
無形固定資産	34,624	18,338
投資その他の資産	762,557	812,652
資産合計	17,774,224	16,116,025
(負債の部)		
流動負債	3,214,678	2,833,557
固定負債	1,000,870	982,675
負債合計	4,215,549	3,816,232
(純資産の部)		
株主資本	13,439,769	12,103,966
評価・換算差額等	118,905	195,827
純資産合計	13,558,675	12,299,793
負債・純資産合計	17,774,224	16,116,025

損益計算書

単位：千円（未満切り捨て）

科 目	当 期 (自2024年8月1日 至2025年7月31日)	前 期 (自2023年8月1日 至2024年7月31日)
売 上 高	9,342,282	8,203,159
売 上 原 価	4,673,766	4,009,838
売 上 総 利 益	4,668,515	4,193,320
販売費及び一般管理費	2,325,774	2,176,159
営 業 利 益	2,342,740	2,017,161
営 業 外 収 益	44,736	76,823
営 業 外 費 用	14,144	5,331
経 常 利 益	2,373,332	2,088,654
税 引 前 当 期 純 利 益	2,373,332	2,088,654
法人税、住民税及び事業税	706,546	617,229
法 人 税 等 調 整 額	△ 30,542	△ 566
当 期 純 利 益	1,697,328	1,471,991

キャッシュ・フロー計算書

科 目	当 期 (自2024年8月1日 至2025年7月31日)	前 期 (自2023年8月1日 至2024年7月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,206,003	1,642,346
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 414,202	△ 292,170
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 404,592	△ 103,438
現金及び現金同等物の期末残高	5,022,029	4,637,782

製品販売

東北大學へ最先端クラスター装置「クラスターH™」を納入

当社は東北大學へ最先端のクラスター装置「クラスターH™」を2025年3月に納入いたしました。本装置は東北大學における材料科学、プロセス開発分野の研究力強化に貢献することを目的としております。

本装置は薄膜形成、エッチング、プラズマ処理、熱処理など、複数のプロセスを真空中で連続して行うことが可能であり、最先端の材料開発を効果的に行なうことができます。



製品販売

ALE(原子層エッチング)装置を国内外の研究機関に複数台納入予定

ICPエッチング装置にALE機能をオプションとして搭載することで、従来のエッチング装置では困難であったナノメートル（ 10^{-9} メートル）レベルの微細加工制御が可能となります。これにより、低ダメージエッチング、エッチング深さの精密制御、優れた均一性を実現いたします。

現在、国内研究機関に2台、オーストラリアの大学に1台を納入予定であり、今後は研究開発の現場での活用が期待されております。



海外事業

開発部社員が米国4大学で講演を実施

2025年6月24日にUniversity of Toronto、25日にYale University、26日にCity University of New York (CUNY) 及びMassachusetts Institute of Technology (MIT.nano) にて、ALE及びBoschに関する講演を実施しました。

講演では、ALE・Boschの原理や当社の処理実績、プロセス調整のポイントについて紹介し、その後に当社装置のプレゼンテーションを行いました。学生及び教職員からは好意的な反応があり、質疑応答も活発に行われました。

本講演を通じて、当社のプロセス技術力を示し、将来的な装置導入に向けた認知拡大につながりました。



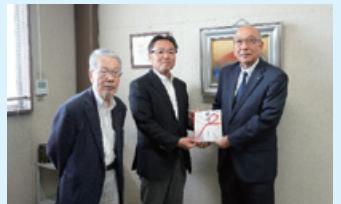
社会貢献

日本赤十字社への寄付について

社会貢献活動の一環として毎年決算期である7月に日本赤十字社への寄付を行っております。

当期は前期に引き続き1,000万円を寄付いたしました。この寄付は、紛争や災害により困難な状況にある人々への支援に尽力されている日本赤十字社の活動を支援するものです。

日本赤十字社は、国内外での緊急援助活動、医療・福祉事業、防災教育など、多岐にわたる人道支援を展開しております。



社会貢献

サムコ科学技術振興財団が 2025年度 第9回研究助成者10名に研究助成金を贈呈

サムコ科学技術振興財団は第9回 薄膜技術に関する研究助成の対象者10名を決定し、9月25日に開催した研究助成金贈呈式において、それぞれ200万円、総額2,000万円を贈呈しました。式典後には、公益財団法人川崎市産業振興財団理事長で、東京大学名誉教授の片岡一則様による記念講演が行われました。



展示会

世界各国のSEMICONショーに出展

当社では重点課題の1つに「海外販売の拡大」を掲げており、海外での展示会にも積極的に出展をしております。当期は9月のSEMICON Taiwan (台湾)、SEMICON India (インド)、11月のSEMICON Europa (ドイツ)、12月のSEMICON Japan (日本)、3月のSEMICON China (中国)、5月のSEMICON SouthEast Asia (シンガポール) などに出展し、最先端技術の紹介や製品発表などを実施しております。



SEMICON Chinaの当社ブース

■ 会社概要

商 号	サムコ株式会社 (英文: SAMCO INC.)
設 立	1979年(昭和54年)9月
事 業 内 容	半導体等電子部品製造装置の製造、販売及び輸出入
資 本 金	1,663,687,288円
従 業 員 数	191名
本 社	〒612-8443 京都市伏見区竹田藁屋町36番地 TEL (075) 621-7841 FAX (075) 621-0936
国 内 拠 点	本社(京都)、東日本営業部(東京)、東海支店(愛知)、つくば営業所(茨城)
海 外 拠 点	米国(カリフォルニア・ニュージャージー)、台湾、シンガポール、中国(上海・北京)、マレーシア
研 究 拠 点	本社研究開発センター(京都)、オプトフィルムス研究所(米国)

■ 役員 (2025年10月21日現在)

代表取締役会長兼CEO	辻 理
代表取締役社長兼COO	川邊 史
取締役専務執行役員	山下 晴彦
取締役執行役員	宮本 省三
社外取締役	佐藤 清志
常勤監査役	柳本 依子
社外監査役	辻村 茂
執行役員	西尾 方宏
	木村 学
	松出 和男
	江崎 裕二
	ヘンリー・チャン
	上杉 能章
	山本 潤
	八田 博文
	山本 仁志

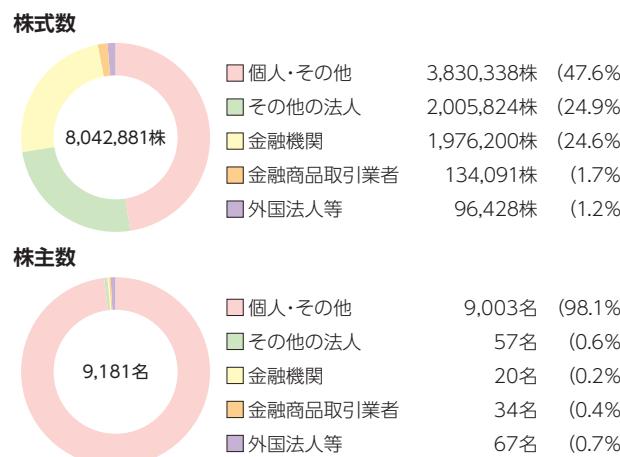
■ 株式の状況

発行可能株式総数	14,400,000株
発行済株式の総数	8,042,881株
株主数	9,181名

大株主の状況

株 主 名	持株数(株)	持株比率(%)
(一財)サムコ科学技術振興財団	1,000,000	12.4
日本マスタートラスト信託銀行(信託口)	920,300	11.4
辻 理	863,907	10.7
サムコエンジニアリング(株)	850,282	10.6
(株)日本カストディ銀行(信託口)	238,900	3.0
辻 一美	201,465	2.5
野村信託銀行(信託口)	153,300	1.9
(株)三菱UFJ銀行	129,600	1.6
立田 利明	103,099	1.3
三菱UFJキャピタル(株)	102,931	1.3

■ 所有者別株式分布状況



株 主 各 位

京都市伏見区竹田藁屋町36番地
サムコ株式会社
代表取締役社長 川邊 史

第46期定期株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第46期定期株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 言

報 告 事 項 第46期(2024年8月1日から2025年7月31日まで)事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。

決 議 事 項

議 案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、普通配当として1株につき60円00銭と決定いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第46期期末配当金は、同封の「第46期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、裏面記載事項をご覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局(銀行代理業者)において払渡し期間内(2025年10月22日から2025年11月28日まで)にお受け取りください。

なお、銀行口座振込をご指定の方には、「第46期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

以 上